



データ資料はこちら >

製品カタログはこちら

型番	COM-G52 5g
容量	5g
熱伝導率	4.22 W/m・K
使用温度範囲	-40℃～300℃

仕様	<p>色 白色</p> <p>非導電性：誘電正接0.0171</p> <p>難燃性：UL-94 V-1適合</p> <p>粘度：30.0Pa・s</p> <p>粘着強度：1.3N/mm²</p> <p>成分：シリコーン樹脂、非導電性フィラー</p> <p>耐項電圧：7Kv非破壊</p> <p>本製品は揮発溶剤は使用しておりません。</p>
----	---

製品PR	<p>電子部品は、蓄熱することにより、その性能がダウンします。従って、パワートランジスタやLEDデバイスなどのパワー半導体素子から発生する熱は外部に逃がす必要があります。熱源(発熱体)となるパワー半導体素子と放熱器(ヒートシンク)との間に塗布することにより、熱拡散を向上させることができます。1液タイプで発熱体と放熱器を接着させることができます。</p> <p>・硬化方法は湿気硬化型となります。(空気中の湿気と反応し硬化します。また、水分にも反応して固まります。) 硬化すれば完全に耐水性となります。</p>
------	---

主な用途	パワートランジスタ、LEDデバイス、CPU等のパワー半導体素子等、発生する熱を放熱する必要のある各部品
------	---

接着可能な素材	ポリカーネート、ABS樹脂等硬質プラスチック、金属材料、鋳物、ガラス、セラミック等
---------	---

使用方法	<ul style="list-style-type: none"> ご使用前に接着面を洗浄後、乾燥させて下さい。 本製品のキャップを外し、接着面全体に薄く塗り、10分～30分程度の放置(セッティングタイム)の後、密着させます。 密着させると約2時間程度で硬化しますが、完全硬化には約10時間(25℃ 湿度50%)の静置が必要です。 塗膜を厚くする時は気泡が混入しないよう注意して下さい。 使用後は、必ずきっちりと容器のフタを締めて冷蔵庫で保管して下さい。 <p>※使用環境、塗布部分の大きさ、塗膜の厚み等により上記時間には差異はございます。あくまでも作業の参考として下さい。</p> <p>※本製品は空気中の湿気・水分と反応して樹脂成分が重合を開始します。その為、空気中の水分と反応させる為に 接着面を接合する前に「セッティングタイム」が必要となります。</p> <p><シロキサンガスの発生について></p> <p>シリコーン樹脂を使用しておりますので、まったく発生しないとはいえませんが、あっても痕跡程度と認識しています。あるお客様が独自で調べたところ「遊離シロキサンは無かったです。」とのご連絡をいただいたことはございますが、弊社では分析等での確認はしておりません。</p>
------	--